

珠海市半导体行业协会

珠半协秘（2023）17号

“珠莞”两地集成电路产业对接交流会邀请函

各会员企业：

集成电路产业作为珠海4大主导产业之一，集成电路设计优势明显，设备制造业、生产制造和封测产业加速发展，拥有良好的产业基础和产业环境。东莞紧邻深圳，形成以封装测试为核心，设备、原材料及应用产业为支撑的产业链。“珠莞”两地产业资源可实现链条互补，协会为推动两地集成电路产业上下游企业信息交流与配套合作，精准对接资源，联合东莞市集成电路行业协会共同主办本次跨地产业对接交流活动。具体安排如下：

一、时间及地点：

时间：2023年08月24日（周三）07:30-17:00

地点：东莞

二、组织单位：

主办单位：珠海市半导体行业协会、东莞市集成电路行业协会

承办单位：中国电子南方软件园

三、活动内容及行程安排：

时间	内容	主讲人
7:30	体育中心集合出发	
8:00-10:00	南方软件园出发前往松山湖园区	
10:00-10:30	介绍参观南软松山湖园区	南方软件园董事长
10:30-11:00	参观园区企业：智峰机电科技（东莞）有限公司	
11:00-11:15	东莞集成电路产业情况介绍	东莞市集成电路行业协会会长
11:15-12:00	“珠莞”两地企业自由交流座谈（附件1）	
12:00-13:30	午餐	
13:30-14:00	出发东莞市集成电路创新中心	
14:10-14:50	介绍参观东莞市集成电路创新中心	集成电路创新中心主任
14:50-15:50	参观交流：三叠纪（广东）科技有限公司	
15:50-18:00	返程	

四、参会人员

企业负责人、技术负责人或其他部门相关负责人。建议每个单位报名人数不超过2名。

五、活动报名

（一）本次活动不收取任何费用，协会统一安排大巴，上车点为珠海体育中心或南方软件园，具体行程详见行程安排。

（二）为便于我们安排车辆，请各参会企业于**8月22日**下

午 17 点前微信扫码二维码报名。



(报名二维码)

六、联系方式

联系人：金子杨 电话：13726259646

附件：1、拟邀请座谈交流的企业名单
2、参观企业介绍



附件1:

东莞拟邀请座谈交流的企业名单

序号	企业名称
1	广东大普通信技术股份有限公司
2	广东赛微微电子股份有限公司
3	合泰半导体（中国）有限公司
4	东莞市长工微电子有限公司
5	安世半导体（中国）有限公司
6	联合科技（UTAC）
7	广东利扬芯片测试股份有限公司
8	广东长兴半导体科技有限公司
9	平晶微电子科技有限公司
10	杰群电子科技（东莞）有限公司

附件2:

参观企业介绍（按参观顺序）

1、智蜂机电科技(东莞)有限公司(简称“智蜂科技”)

公司总部设在东莞松山湖，成立于2017年，2021年整体营收超8000万，2022年计划超2个亿。团队目前有多个国家基金投资。计划三年内登陆北交所。有在建一万平方生产研发基地和仓储中心。公司已在深圳、东莞、珠海、上海、昆山、武汉、合肥、成都、重庆、西安、天津、厦门分别建立了客户服务中心，营销和技术服务网络覆盖全国半导体行业版图，为全国数千家客户提供优质产品服务。公司致力“成为世界一流的半导体生产制程及可靠性解决方案集成商”，立足半导体制造行业上游供应端，目标是在半导体行业的基板封装领域建立起全球规模技术最尖端的工业检测智能装备方案平台；自公司成立以来，已成功研发针对ic载板生产制程检测方案、ic载板可靠性测试方案、半导体物理和化学实验室方案、半导体可靠性测试实验室方案。通过开展定制化生产需求全案设计、从实验室规划到精密仪器设备定制及全方位瞬时响应售后等全价值链服务，给封测厂商实现高端产品研发与生产保驾护航，为提升产品良率提供专业高效的一站式综合解决方案。

2、东莞市集成电路创新中心

东莞市集成电路创新中心（简称“集成电路创新中心”）是在东莞市人民政府和电子科技大学指导，东莞市科学技术局、东莞市发展和改革局联合授牌，依托电子科技大学集成电路科学和工程学院、电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室，由电子科技大学广东电子信息工程研究院牵头，联合气派科技（股票代码：688216）、东电检测、三叠纪科技、砺芯半导体、华拓半导体等产业链企业和东莞实业投资集团、东莞科技金融集团等市属国企平台共建，填补了东莞市集成电路专业创新平台的空白。

集成电路创新中心于2022年开始筹建运营，规划总投资5亿元，以提升产业技术创新能力和加强产业生态建设为目标，集聚优质的科研、人才、产业、资本等创新要素，建设覆盖集成电路企业完整研发周期、全技术服务要素的产品开发、中试制造、测试验证、人才培养和应用示范平台，建立高效的政产学研用体系，开展产业共性技术研究，支撑高校及科研院所科技成果转化和产业链企业聚集，赋能集成电路产业实现高质量发展。

集成电路创新中心于2022年成功引进了以电子科技大学原副校长杨晓波教授团队为带头人的东莞市第一个战略科学家团队。目前，集成电路创新中心已引进电子科技大学张波教授团队、张继华教授团队等高端科研团队11个；聚集集成电路产业链企业30余家；建成了芯片与元器件失效分析、可靠性、ESD和LatchUp实验室，射频、Wiff、蓝牙BQB测试实验室，芯片工程封装中心和TGV三维封装中试制造产线；建成了东莞、重庆和成都三个集成电路全产业链人才培养和实训基地，开设FPGA（人工智能）、FPGA逻辑、SoC系统及数字IC设计、版图设计、封装测试、嵌入式（工业控制）等集成电路全产业链高端技能人才培养。

3、三叠纪（广东）科技有限公司

成都迈科科技有限公司的全资子公司，立足后摩尔时代三维集成微系统关键材料与集成技术，在行业内率先提出TGV3.0，首次突破亚10微米通孔和填充技术，被四川省国防工办鉴定为整体国际先进，其中通孔尺寸、孔密度和深径比国际领先，是国内玻璃通孔技术的倡导者与引领者。公司先后获得成都技转、成都科服、院士基金、帝尔激光（股票代码：300776）、一鑫资本等战略投资。

公司是电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室成果转化企业，在玻璃高深宽比3D微结构、超高深径比填充、高品质IPD方面具有领先的技术能力。研发团队承担了多项国家、省部级重大科研项目，先后获得全国创新争先奖牌、国家技术发明奖、四川省技术发明奖等。公司已通过国家高新技术企业认证、ISO9001质量体系认证。

2022年公司在东莞松山湖建成TGV基板与三维集成封装中试线，并参与组建“集成电路与半导体特色工艺战略科学家团队”，成为国内具有显著特色和优势的TGV研发与生产基地。目前已形成TGV工艺服务、IPD无源集成器件、3D微结构玻璃和TGV特色工艺装备的四类产品体系，主要应用在先进三维系统封装、高Q微波/THz器件、光学/射频MEMS、微流控芯片等领域，已经为中国电科、肖特玻璃、华为、康佳光电、京东方等龙头企业供货。未来力争持续领跑TGV技术，成为三维封装领域的“领头羊”。热忱欢迎兄弟单位协同发展，支撑东莞市集成电路封装技术跨越发展，为我国集成电路产业自立自强贡献力量。